

VAKSiS

R&D AND ENGINEERING

RIE-handy®



ÜRÜN BİLGİSİ

Reaktif-iyon dağlama (RIE) bir dağlama teknolojisidir. RIE sisteminin vakum odası silindirikdir. Bu sistem, kimyasal reaktif plazma ile yongaların üzerindeki kaplanmış materyallerin yüzeyden kaldırılması için kullanılmaktadır. Plazma içindeki yüksek enerjili iyonlar yonganın yüzeyine hücum eder ve yüzeyle etkileşir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

En Düşük Basınç	≈ 10 Torr
Alttaş Boyutu	4" - 8" çapında
Soğutma	Alttaş Tutucusu
Yükleme	Kaldırılarak açılan üst kapaktan veya yükleme odasından
Kontrol	Tam Otomatik
Güç Kaynakları	RF Güç Kaynağı
Yükleme	Kuvars tüpün bir ucundan
Farklı Gaz Türleri için Kütle Akış Kontrolcüsü Sayısı	Maks. 12
Gaz Kabini.....	Dahildir ve Sistem Yazılımına Entegredir
Ek Gaz Emniyeti	İstenildiğinde sunulabilmektedir

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanılabilir bir yazılıma sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol yazılımı değil, ayrıca kullanıcının özel kaplama deneyimlerini tasarlayabildiği, daha önceden kullanılan proses parametrelerini inceleyebildiği ve geliştirilmiş reçeteleri/kaplamaları kullanabildiği bir yazılımdır.

Yazılım tarafından yürütülen operasyonlarda insan ve makine güvenliği önem açısından ilk sıradadır. Grafik kullanıcı arayüzü kullanıcıya kullanım sırasında sistem durumunu görme imkanı sunmaktadır.